

규격서

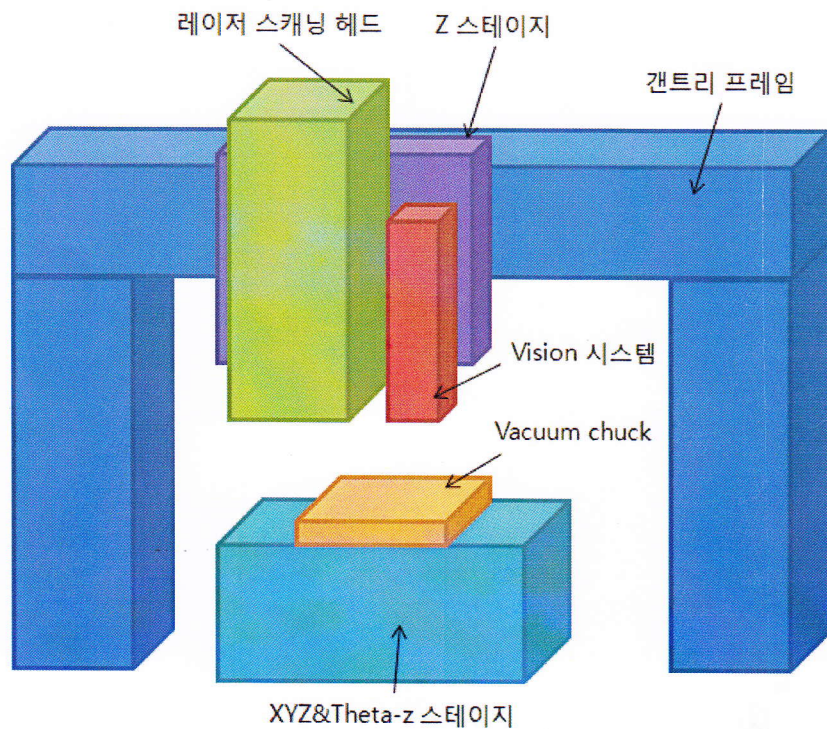
품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
레이저 마이크로 가공 및 측정 시스템	set	1

가. 전체 시스템 규격

A. 시스템 용도

- 유연 인쇄 전자 소자 생산을 위한 공정 중 레이저 미세 패터닝 및 레이저 신터링 공정을 빔 스캔 방식을 통해 구현할 수 있는 장비. 실제 소자 생산에 적용하기 위해 전 레이어에 대한 정밀 얼라인 작업이 가능하며 패터닝 후 실시간으로 패턴을 검사할 수 있는 검사 모듈을 포함함. 정밀 얼라인 및 검사 작업을 위해서 XYZ 및 Theta-z 정밀 스테이지가 포함되어야 함.

B. 시스템 구성 개념도



C. 시스템 사양

항목		사양	비고
미세 패터닝	빔 스캔 영역	200X200mm 이상	
	최소 Spot size	30um 이하	
	스캔 속도 (Marking)	2.0m/s 이상	
	Writing 속도	400cps 이상	
패턴 계측	Lateral 분해능	2um 이하	
	픽셀수	5M 이상	
Align 정도	Repeatability	+/-2um	
	Accuracy	+/-5um	
XYZ 스테이지	행정거리	XY(250mm), Z(100mm), Theta-z (5°)	
	분해능	XYZ(0.1um), Theta-z(5arcsec)	
	속도	XY(100mm/s), Z(1mm/s)	
레이저 및 빔 스캐너	레이저 파장	532nm	
	스캐너 Aperature	10mm 이상	
	Repeatability	30urad 이하	

나. 그 외 일반 규격 사항

▷ 검수 스펙

- 위의 상세 규격을 모두 만족하여야 함
- 위 성능에 대한 공정 Setup 및 평가 결괄를 제출하여야 함

▷ 업체 경력

- 초정밀 스테이지 및 정밀 계측기 관련 사업 3년 이상
- 대기업 납품 이력
- 소프트웨어 개발 지원 가능 인력 보유

▷ Safety

- 사용 시 사용자의 safety를 위한 안전장치에 대한 자료 제시
- 정전, 단수 등 갑작스런 utility의 공급 중단 등과 같은 비상 상황에서의 장비보호 및 안전보장에 대한 기능 data 첨부

▷ A/S 방안

- 납품 후 A/S에 대한 상세 방안 제시

▷ Spare Parts

- 1년간 사용에 필요한 spare part 제안서 제출 시 list 첨부

▷ Operating manual : 2 set 제공

▷ 납기 : 계약일로 부터 3주 이내